**中国传感器与物联网产业联盟**

**会员申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位具体信息**（\* 为必填项目） | | | | | | | | | | | |
| \* 单位名称 |  | | | | | | | | | | |
| \* 单位地址 |  | | | | | | | | | | |
| \* 单位网址 |  | | | | | | | | | | |
| 法人或  负责人 | \* 姓名 | |  | | | | \* 电话 | | | |  |
| \* 职务 | |  | | | | \* 手机 | | | |  |
| \* E-mail | |  | | | | | | | | |
| 联系人 | \* 姓名 | |  | | | | \* 电话 | | | |  |
| \* 职务 | |  | | | | \* 手机 | | | |  |
| \* E-mail | |  | | | | | | | | |
| \* 经济性质 | □国有 □外资 □合资 □民营 | | | | | | | | | | |
| \* 年度营业额 | □1000万以下 □1000-3000万 □3000-5000万 □5000-7000万 □7000万-1亿 □1亿以上 | | | | | | | | | | |
| 公司简介  （核心技术、产品、业务）  200-300字 |  | | | | | | | | | | |
| \* 申请会员类别 | □ 理事会员 □普通会员 | | | | | | | | | | |
| 对联盟工作的建议和需求 |  | | | | | | | | | | |
| **产业领域**（请标注出在贵单位所处技术领域及产业链环节，可多选） | | | | | | | | | | | |
| □ 高校、科研院所 | | | | □ 行业协会、组织 | | | | | | | |
| □ 半导体 | □ 消费类 | | | □ 航空航天 | | | | □ 家电 | | | |
| □ 工业 | □ 汽车 | | | □ 农业 | | | | □ 医疗 | | | |
| □ 通讯 | □ 建筑 | | | □ 教育及培训 | | | | □ 金融 | | | |
| □ 媒体 | □ 能源 | | | □ 服务（展会/律行/咨询机构/孵化器） | | | | | | | |
| 其它产业领域： | *请填写* | | | | | | | | | | |
| **产业链分工**（半导体产业领域企业请标注出贵单位所处产业链分工，可多选） | | | | | | | | | | | |
| □ IDM | □ 半导体设备 | | | | □ 半导体材料 | | | □ 芯片设计 | | | |
| □ 晶圆制造 | □ 封装测试 | | | | □ 系统集成 | | | □ 芯片代理 | | | |
| □ 其他 | *请填写* | | | | | | | | | | |
| **专委会**（请标注出贵单位所感兴趣的专委会，可多选） | | | | | | | | | | | |
| □ 智慧环境/水务 | | □ 智联交通 | | | □ 工业互联网 | | | | □ 工业传感器 | | |
| □ 成果转化 | | □ 光电技术 | | | □ 智慧生活 | | | | □ 信息安全 | | |
| □ 智慧农业 | | □ 汽车电子 | | | □ 科学仪器 | | | | □ 产学研 | | |
| □ 传感器封测技术 | | | | | □ 物联网智能无线网络通信 | | | | | | |
| □ 健康医疗传感与应用 | | | | | □ 能源工业传感器与应用技术 | | | | | | |
| □ 其他 | | | | | *请填写* | | | | | | |
| **服务需求（请标注出贵单位所需要的服务，可多选）** | | | | | | | | | | | |
| □ 人才培训 | □ 咨询服务 | | | | □ 融资对接 | | | | □ 对接服务 | | |
| □ 专利申请 | □ 媒体采访 | | | | □ 宣传推广 | | | | □ 展会/会议 | | |
| □ 其他 | *请填写* | | | | | | | | | | |
| **感兴趣的行业领域（可多选）** | | | | | | | | | | | |
| □ 能源 | □ 智能制造 | | | | | □ 环境监测 | | | | □ 汽车产业链 | |
| □ 航空航天 | □ 智慧农业 | | | | | □ 医疗器械 | | | | □ 家电产业链 | |
| □ 船舶海工装备 | □ 城市基础建设 | | | | | □ 其他 | | | | *请填写* | |
| 注：请用正楷字体填写，将填好的登记表加盖公章扫描发送email至联盟秘书处 | | | | | | | | | | | |
| 申请单位公章处或负责人签字  （我单位自愿加入本联盟，拥护联盟章程，执行联盟权利与义务） | | | | | | | | | | | |
| 本单位LOGO，请另外附件  \*联盟保留条款最终解释权 | | | | | | | | | | | |

**联盟秘书处联系人：李 翔 | 13764186022**

**联盟秘书处邮件：SIA@si-wave.net**

**地址：上海市嘉定区皇庆路333号，201800**

**官网：[www.sensors-iot.net](http://www.sensors-iot.net)**